

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年2月7日(07.02.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/018777 A1

(51) 国際特許分類:

H01B 13/00 (2006.01) H01B 1/20 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H05K 1/09 (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01) H05K 3/24 (2006.01)
H01B 1/16 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2012/069376

(22) 国際出願日: 2012年7月30日(30.07.2012)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2011-170083 2011年8月3日(03.08.2011) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社(Hitachi Chemical Company, Ltd.)
[JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 中子 偉夫(NAKAKO, Hideo) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台4-8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 山本 和徳(YAMAMOTO, Kazunori) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台4-8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 神代 恭(KU-MASHIRO, Yasushi) [JP/JP]; 〒3080861 茨城県筑西市森添島1-9-19 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 横澤 舜哉(YOKOSAWA, Shunya) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台4-8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 納堂 高明(NUODOU, Takaaki) [JP/JP]; 〒3080861 茨城県筑西市森添島1-9-19 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 稲田 麻希(INADA, Maki) [JP/JP]; 〒

3004247 茨城県つくば市和台4-8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 黒田 杏子(KURODA, Kyoko) [JP/JP]; 〒3080861 茨城県筑西市森添島1-9-19 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 膝舘 祥治, 外(HIZATATE, Shoji et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 H K 新宿ビル7階 太陽国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: COMPOSITION SET, ELECTROCONDUCTIVE SUBSTRATE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND ELECTROCONDUCTIVE BINDING MATERIAL COMPOSITION

(54) 発明の名称: 組成物セット、導電性基板及びその製造方法並びに導電性接着材組成物

(57) Abstract: The present invention provides a composition set comprising a conductor layer forming composition containing inorganic particles including a dispersion medium and a metal oxide, and an electroconductive binding material composition containing a binder and electroconductive particles having a number average particle size of 1 to 3000 nm.

(57) 要約: 本発明は、分散媒及び金属酸化物を含む無機粒子を含有する導体層形成用組成物と、バインダ材及び数平均粒子径が1 nm~3000 nmである導電性粒子を含有する導電性接着材組成物とを含む組成物セットを提供する。



WO 2013/018777 A1